

征文通知

第九届固态和集成电路国际会议

ICSICT 2008

2008年10月20-23, 北京

Co-Sponsored by:

IEEE Beijing Section

Chinese Institute of Electronics (CIE)

Technical Co-Sponsored by

IEEE Electron Devices Society

IEEE EDS Beijing Chapter

Supported by:

Peking University

National Natural Science Foundation of China

Tsinghua University

Institute of Microelectronics, CAS

In Cooperation with:

IEEE Solid-State Circuits Society

IEEE HongKong EDS/SSCS Chapter

IEEE SSCS Beijing Chapter

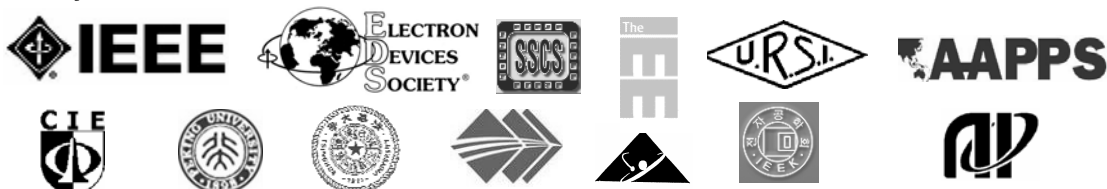
Japan Society of Applied Physics

Electronics Division of IEE (U.K)

URSI Commission D

Institute of Electronics Engineers of Korea

Association of Asia Pacific Physical Societies



大会组织

General Co-Chairs:

Yangyuan Wang

Peking University, China

Chenming Hu

University of California, Berkeley, USA

Advisory Committee Co-Chairs:

Zhijian Li

Tsinghua University, China

Dexin Wu

Institute of Microelectronics, CAS, China

Chih Tang Sah

University of Florida, USA

Program Committee Co-Chairs:

Ru Huang

Peking University, China

Juin J. Liou

University of Central Florida, USA

Hiroshi Iwai

Tokyo Institute of Technology, Japan

Cor Claeys

IMEC, Belgium

Jason Woo

University of California, Los Angeles, USA

Donggun Park

Samsung Electronics, Korea

Jun Xu

Tsinghua University, China

Organizing Committee Co-Chairs:

Mengqi Zhou

Chinese Institute of Electronics, China

Bin Zhao

Freescall Semiconductor, Inc., USA

Tianchun Ye

Institute of Microelectronics, CAS, China

Xing Zhang

Peking University, China

Albert Wang

University of California, Riverside, USA

会议简介:

第九届 ICSICT 会议 (International Conference on Solid-state and Integrated Circuit Technology) 将于 2008 年 10 月 20 日—23 日在北京举办。会议由 IEEE 北京分会和中国电子学会主办。

ICSICT 是在中国举办的有关固态器件、集成电路方面规模最大、影响最大的国际会议。本次会议将是在中国的半导体事业蓬勃发展的时期召开的一次盛会。会议将邀请中、美、日、韩、欧洲及亚太其他国家专家作大会报告和分会邀请报告。这次会议将是国内外微电子、纳电子、光电子等领域的研究人员之间交流信息和了解国际、国内最新进展的一次很好的机会。

会议将组织 short course、技术参观等活动,会议闭幕时还将颁发优秀学生论文奖。会议论文集具有 IEEE 统一书号,并在 IEEE 网站上刊登电子版。

2004 年第七届和 2006 年第八届的 ICSICT 会议文章已经被 EI 收录

征文范围: (文章的内容要求在以下领域,但不限于以下内容)

- 硅基 MOS 器件
- 先进的集成电路工艺技术
- 硅集成电路和制造
- 先进存储器技术
- 化合物半导体技术
- 器件和互连的可靠性
- 模型和模拟
- 半导体材料和材料表征
- 量子电子和纳电子
- 光电器件和技术
- MEMS 技术
- 数字、模拟和混合信号电路
- 射频和微波电路
- 低功耗电路
- EDA 和 DFM 技术
- 集成电路测试技术
- 有机半导体器件和技术
- 封装技术
- 设备技术
- 其他

投稿要求:

会议要求**英文全文**投稿,不接受摘要投稿。如果稿件被录用,将按照投稿的样式出版。论文格式的要求以及电子模板可以在会议网站下载。请登录会议网站注册用户然后在**网上电子投稿**。文件格式要求是 PDF 格式。

投稿截止日期: 2008 年 5 月 31 日

会议网站: <http://www.ime.pku.edu.cn/icsict>

Email 联系: icsict2008@ime.pku.edu.cn